

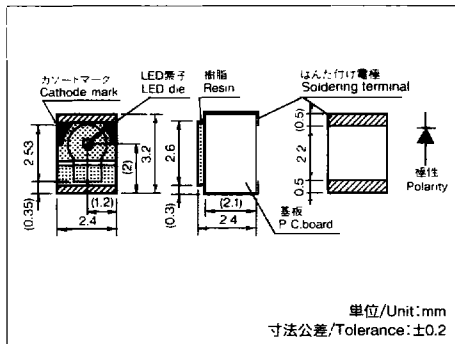
INFRARED CHIP LEDs

CITISENSOR

小型表面実装型 赤外チップLED CL-200IR-X

Miniature Surface Mountable Infrared Chip LED CL-200IR-X

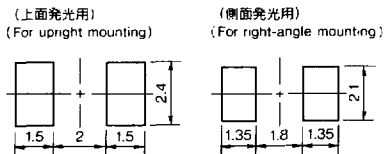
■外形寸法図/Outline drawing



推奨はんだ付けパターン

The following soldering patterns are recommended for reflow-soldering:

基板はんだ付けパターン
Soldering pattern on P.C. Board



■特徴

1. 上面発光及び側面発光のいずれにも実装可能。
2. 外形寸法は3.2(L)×2.4(W)×2.4(H)mm小型・角型サイズ。
3. チップマウンターによるプリント基板への自動実装可能。
4. リフロー半田対応。

■用途

1. リモコンの送信用赤外光源。
2. 各種光センサ用光源。

■Features

1. Both mounting available; namely, upright and right-angle mounting
2. Small and square size, dimensions : 3.2(L)×2.4(W)×2.4(H)mm
3. Automatic mounting by chip mounter available
4. Reflow soldering available

■Application

1. IR transmitter for remote control commander
2. IR light source for opto-sensors

■絶対最大定格/Maximum absolute rating

(Ta=25°C)

項目/Item	記号/Symbol	定格/Rating	単位/Unit
許容損失/Power dissipation	P _d	80	mW
順電流/Forward current	I _F	50	mA
パルス順電流/Forward pulse current	I _{FP}	1※1	A
逆電圧/Reverse voltage	V _R	5	V
動作温度範囲/Operating temperature	T _{OP}	-30~+85	°C
保存温度範囲/Storage temperature	T _{st}	-35~+90	°C

*1.Duty比 1%以下 f=1KHz

*1.Duty ratio ≤1% Frequency=1KHz

■電気的光学的特性/Electro-optical characteristics

(Ta=25°C)

部品コード/ Code for parts	発光色/ Lighting color	V _F (I _F =50mA)		λ _p nm	Δλ nm	I _e (I _F =50mA)	
		TYP (V)	MAX (V)			MIN (mW/sr)	TYP (mW/sr)
CL-200IR	赤外/Infrared	1.3	1.6	950	45	7	12

■諸特性/Characteristics

